

硅片切割机

简介

硅片切割机又名硅片激光切割机、激光划片机。硅片切割机工作原理是利用高能激光束照射在工件表面，使被照射区域局部熔化、气化、从而实现硅材料的切割。硅片切割机主要用于金属材料及硅、锗、砷化镓和其他半导体衬底材料的划片和切割，可加工太阳能电池板、硅片、陶瓷片、铝箔片等，工件精细美观，切边光滑，可极大地提高加工效率和优化加工效果。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7090.html>